

<<电子技术实训指导>>

图书基本信息

书名：<<电子技术实训指导>>

13位ISBN编号：9787302119098

10位ISBN编号：7302119090

出版时间：2005-11

出版时间：清华大学

作者：朱永金

页数：283

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子技术实训指导>>

内容概要

本书是高职高专电子信息类专业电子技术实践与技能训练教材。

全书共8章，分为3个实训板块。

主要包括：元件认识与测试，印制电路板制作及电子安装工艺；模拟、数字电路的课程设计及电路制作、安装和测试；典型整机电路的安装、调试和故障检修等。

本书也适用于成人大专、中等职业教育电子信息类专业实践教学和职业培训机构对电子信息类工种的培训用书，也是电子技术爱好者的参考用书。

<<电子技术实训指导>>

书籍目录

电子技术实训指导第1部分	电子技术基础实训	第1章	元件的认识与检测实训	1.1	阻抗元件的认识与测试	
	1.1.1	阻抗元件的标称值与标志	1.1.2	电阻器	1.1.3	电容器
	1.1.4	电感和变压器	1.1.5	实训内容及要求	1.2	半导体分立元件的检测
	1.2.1	国产半导体元件的命名	1.2.2	晶体二极管	1.2.3	晶体三极管
	1.2.4	晶闸管	1.2.5	场效应管	1.2.6	实训内容及要求
	1.3	半导体集成电路识别与测试	1.3.1	集成电路的分类	1.3.2	国产集成电路的命名
	1.3.3	集成电路封装与引脚识别	1.3.4	集成电路的检测方法	1.3.5	实训内容及要求
	1.4	开关及继电器选用	1.4.1	开关	1.4.2	继电器
	1.4.3	实训内容及要求	第2章	印制电路板制作	2.1	印制电路板的特点
	2.2	印制电路板的设计基础	2.2.1	印制板用基材	2.2.2	过孔
	2.2.3	导线尺寸	2.2.4	焊盘尺寸	2.2.5	金属镀(涂)覆层
	2.2.6	印制接触片	2.2.7	非金属涂覆层	2.2.8	永久性保护涂覆层
	2.2.9	敷形涂层	2.2.10	印制电路板的尺寸	2.2.11	阻燃性
	2.2.12	印制电路板基板的选择	2.3	印制电路板设计过程	2.3.1	线路图设计的基本方法
	2.3.2	印制电路板图设计中应注意的事项	2.3.3	印制电路板的设计	2.3.4	PCB计算机辅助设计软件
	2.4	印制电路板的简易制作	2.4.1	敷铜板的选用	2.4.2	印制电路的制作方法
	2.4.3	印制电路板制作实训及要求	第3章	焊接与安装技术	3.1	焊接的基础知识
	3.2	锡焊接工具与材料	3.2.1	手工锡焊接的工具	3.2.2	焊接材料
	3.2.3	锡焊的条件	3.2.4	实训内容	3.3	手工焊接工艺
	3.3.1	元件的手工焊接	3.3.2	拆焊与重焊	3.4	电子装配工艺概述
	3.4.1	元器件引脚的成形要求	3.4.2	元件的安插方法和要求	3.4.3	印制电路板的装配
	3.4.4	实训内容	3.5	波峰焊与回流焊	3.5.1	波峰焊接
	3.5.2	回流焊接	3.6	表面组装技术	3.6.1	表面组装技术的发展
	3.6.2	表面组装技术的组成	3.6.3	用表面组装技术组装的电子产品的优点	3.7	其他组装技术
	3.7.1	微组装技术	3.7.2	MPT主要技术	3.7.3	实训内容
第2部分	课程设计实训	第4章	EWB电子电路仿真平台的使用	第3部分	整机安装与调试实训	
附录A	TTL数字集成电路索引	附录B	CMOS数字集成电路索引	附录C	通用运算放大器集成电路索引	
附录D	常用集成电路引脚功能图	附录E	常用仪器的使用参考文献			

<<电子技术实训指导>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>